

# 46-605 Economy Version

Buchsenleisten RM 1,27mm, gerade/gewinkelt - Bauhöhe 3,4 / 4,3mm

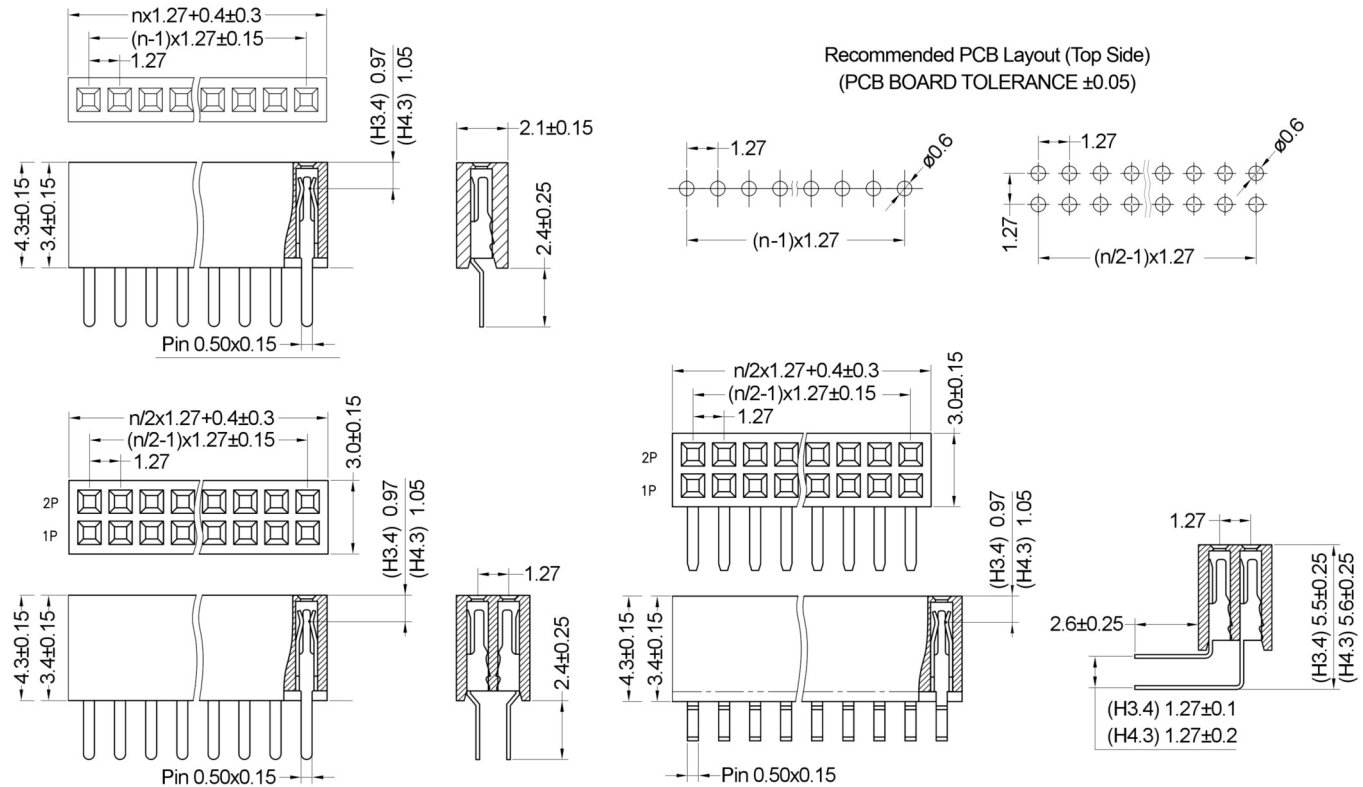
Female Headers, 1.27mm Pitch, Straight/Right-Angled - 3.4/4.3mm Profile

## Technische Daten / Technical Data

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Isolierkörper         | Thermoplast, nach UL94 V-0                            |
| Insulator             | Thermoplastic, rated UL94 V-0                         |
| Kontaktmaterial       | Kupferlegierung                                       |
| Contact Material      | Copper alloy                                          |
| Kontaktoberfläche     | Au über Ni                                            |
| Contact Surface       | Au over Ni                                            |
| Durchgangswiderstand  | < 20 mΩ                                               |
| Contact Resistance    | < 20 mΩ                                               |
| Isolationswiderstand  | > 1000 MΩ                                             |
| Insulation Resistance | > 1000 MΩ                                             |
| Spannungsfestigkeit   | 500 V AC/DC                                           |
| Test Voltage          | 500 V AC/DC                                           |
| Nennstrom             | 1 A                                                   |
| Current Rating        | 1 A                                                   |
| Temperaturbereich     | -40 °C ... +105 °C                                    |
| Temperature Range     | -40 °C ... +105 °C                                    |
| Verarbeitung          | 230 °C für 30-60 Sekunden<br>(260 °C für 10 Sekunden) |
| Processing            | 230 °C for 30-60 seconds<br>(260 °C for 10 seconds)   |



Doppelfederkontakte für  
Vierkantstifte 0,40mm.  
Dual beam contacts accept  
0.40mm square pins.



| Series        | Contacts*                                                               | Rows*                      | Type*                       | Height*                         | Plating                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>46-605</b> | <b>016</b>                                                              | <b>1</b>                   | <b>1</b>                    | <b>2</b>                        | <b>00</b>                   |
|               | 003-050 Einreihig<br>Single Row                                         | 1 Einreihig<br>Single row  | 1 Gerade<br>Straight        | 1 Bauhöhe 3,4mm<br>Height 3.4mm | 00 Vergoldet<br>Gold plated |
|               | 006-080 Zweireihig<br>Double Row                                        | 2 Zweireihig<br>Double row | 2 Gewinkelt<br>Right-angled | 2 Bauhöhe 4,3mm<br>Height 4.3mm |                             |
|               | 008-040 Zweireihig (H4.3, gewinkelt)<br>Double Row (H4.3, right-angled) |                            |                             |                                 |                             |
|               | Weitere Polzahlen auf Anfrage<br>More numbers of contacts on request    |                            |                             |                                 |                             |

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

## Reflow-Lötverfahren

### Reflow Soldering Information

#### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert                        |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150 °C                          |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200 °C                          |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60 – 180s                       |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | untere Temperaturangabe [°C]    |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | laut Angabe im Datenblatt [sec] |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s                   |
| Höchsttemperatur $T_P$               | obere Temperaturangabe [°C]     |
| Dauer Höchsttemperatur               | laut Angabe im Datenblatt [sec] |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s                        |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$ | max. 8m                         |

#### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values              |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150 °C                  |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200 °C                  |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60 – 180s               |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | Lower Temperature [°C]  |
| Duration above $T_L$                 | Acc. to datasheet [sec] |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s           |
| Peak Temperature $T_P$               | Upper Temperature [°C]  |
| Duration Peak Temperature            | Acc. to datasheet [sec] |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s                |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | max. 8min               |

